

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成22年4月22日(2010.4.22)

【公表番号】特表2008-535252(P2008-535252A)

【公表日】平成20年8月28日(2008.8.28)

【年通号数】公開・登録公報2008-034

【出願番号】特願2008-504102(P2008-504102)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/02 (2006.01)

H 0 1 L 21/683 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/02 Z

H 0 1 L 21/68 N

【手続補正書】

【提出日】平成22年3月2日(2010.3.2)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

マイクロエレクトロニクス用の加工物を処理するための装置であって、

a) 前記加工物が、処理中に位置決めされる支持部材、及び、

b) 前記加工物の外部周辺に近接したダクト入口をそれぞれ有する複数のダクト通路の部分に形成され、移動可能かつ入れ子化可能な複数のバッフル部材を有し、

排出されたストリームが前記下流ダクトへの入口に入る前に、排出されたストリームから液体が分離可能なように、少なくとも一つの移動可能かつ入れ子化可能な前記バッフル部材が下流へのダクト部への入口を覆い隠すフードを有し、前記下流ダクトへの前記入口が、前記フードの移動によって開かれかつ絞られるように制御されることを特徴とする装置。

【請求項 2】

前記バッフル部材の相互の相対的な位置決めにより、前記ダクト通路を選択的に開き又は絞ることを特徴とする請求項 1 に記載の装置。

【請求項 3】

マイクロエレクトロニクス用の加工物を処理するための装置であって、

a) 前記加工物が、処理中に位置決めされる支持部材、及び、

b) 前記加工物の外部周辺に近接したダクト入口をそれぞれ有する複数のダクト通路の部分に形成され、移動可能かつ入れ子化可能な複数のバッフル部材を有し、

該バッフル部材の少なくとも一つの少なくとも一部が、液体材料と気体材料の分離が起こるトラップ領域を形成するように、下流ダクト部への入口に対して相対的移動が可能であることを特徴とする装置。

【請求項 4】

前記トラップ領域は、一つ又はそれ以上のドレインポートを有することを特徴とする請求項 3 に記載の装置。